

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-024

江苏日盈电子股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
R&Y Electronics North America Inc （以下简称“美国日盈”）	300 万美元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	300 万美元（含本次）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.56
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足全资孙公司美国日盈的生产经营需要，2026年3月31日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签署了《保证合同》，为美国日盈向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行申请300万美元的银行授信提供连带责任保证，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	美国日盈		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司		
主要股东及持股比例	公司通过日盈电子（香港）有限公司间接持股100%		
注册号	802,941,897		
成立时间	2022年11月9日		
注册地	3250 W BIG BEAVER RD		
注册资本	500万美元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	传感器等产品的生产、销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日	2024年12月31日
	资产总额	3,887.53	1,830.96
	负债总额	2,058.29	1,118.59
	资产净额	1,829.24	712.37
	营业收入	287.47	144.19
	净利润	-878.02	-529.34

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：江苏日盈电子股份有限公司
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行
- 3、债务人：R&Y Electronics North America Inc
- 4、保证金额：最高不超过300万美元（含）（或等值人民币）
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。
- 7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

截至本公告披露日，美国日盈在美国密歇根州建设的美国工厂已投入使用，公司本次为美国日盈贷款提供担保系为了满足其运营资金需求，为其提供担保有利于推进公司国际化业务的开展。美国日盈作为公司全资孙公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力情况，本次担保事项风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为全资孙公司提供担保，是基于美国日盈日常经营资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.56%。公司及其控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日